

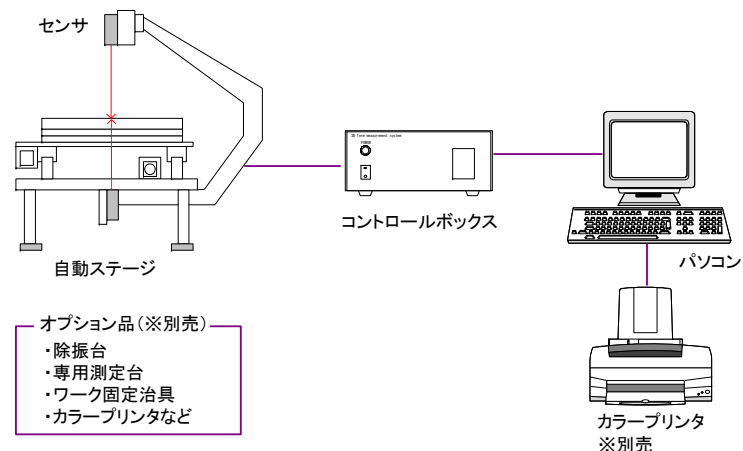
TTS2100 シリーズ  
汎用機

# 非接触厚み測定装置



汎用機は一部写真と異なります

システム構成図



## 特長

- ・ **ダブルレーザー方式**のため高精度で安定した測定
- ・ 非接触なので検査対象を傷つける心配がありません
- ・ **透明体**、あるいは**鏡面体**の測定が可能
- ・ 測定対象物による影響が非常に少ない
- ・ 多彩な計測モードを用意
- ・ ご使用の対象物形状に合わせてシステム構築が可能な特注も承っております

## 用途

- ・ レンズやガラス基板の厚み測定
- ・ 液晶基板や半導体ウェハの厚み測定
- ・ ステンレスやチタン、アルミ、鉄板などの金属製品  
あるいは樹脂、ゴム、フィルム、ガラスなどの非金属製品の厚み測定

## 汎用機仕様

項目	型式別					
	TTS2100AW	TTS2100BW	TTS2100CG	TTS2100DG	TTS2100EG	TTS2100FG
作動距離	6mm	30mm	10mm	30mm	80mm	150mm
厚み測定範囲(シングルレーザ方式の場合はこの1/2となります)	1.2mm	4mm	4mm	20mm	60mm	160mm
測定方式	共焦点式	共焦点式	三角測距式	三角測距式	三角測距式	三角測距式
透明体・鏡面体の計測	計測可	計測可	計測可	計測可	計測可	計測可
光源	レーザ	半導体レーザ				
	波長	670nm 可視光 CLASS I		650nm CLASS I	650nm CLASSⅢA	650nm CLASSⅢA
	出力	170 $\mu$ W	170 $\mu$ W	0.3mW	4.8mW	4.8mW
スポット径	$\phi$ 2 $\mu$ m	$\phi$ 7 $\mu$ m	20×500 $\mu$ m	30×850 $\mu$ m	70×1100 $\mu$ m	120×1700 $\mu$ m
分解能	0.01 $\mu$ m	0.01 $\mu$ m				
繰り返し精度			0.01 $\mu$ m	0.05 $\mu$ m	0.2 $\mu$ m	0.5 $\mu$ m
直線性	$\pm$ 3 $\mu$ m	$\pm$ 6 $\mu$ m	$\pm$ 0.6 $\mu$ m	$\pm$ 5 $\mu$ m	$\pm$ 15 $\mu$ m	$\pm$ 40 $\mu$ m
センサ部移動量	Z軸ステージ					
	半固定					
XY自動ステージ部	移動量(測定エリア)	100mm				
	最小送り量	0.2 $\mu$ m/STEP				
	最高移動速度	20mm/SEC				
	テーブル面	200×200				
	耐荷重	5Kg				
	位置決め精度	20 $\mu$ m以内				
	繰り返し位置決め精度	$\pm$ 3 $\mu$ m以内				
	バックラッシュ・ロストモーション	5 $\mu$ m以内				
制御部	パソコン(オプション)	PC/AT互換機				
	ステージドライバ	5相マイクロステップドライバ				
	USB1/F	USB1. 1/2. 0				
ソフトウェア WinLaser3D	OS Windows2000 ,XP 対応					
オプション	パソコン					
	カラープリンタ					
	卓上型防振台					
	防振台付き測定デスク					
	各種ワーク固定治具					

仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

この仕様以外にも対応可能ですので  
ご相談ください